

2-1-2-29 SR 下テープ残り／SR 基底的胶带屑／Tape left under solder resist

【特徴】SRの下に識別テープやセロテープなどが残っている状態の欠陥

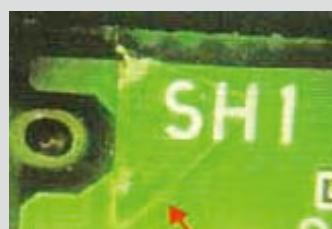
【特征】SR 的基底残留标识胶带、或者透明胶带的屑的缺陷。

【Characteristics】Identification tape, cellulose tape or the like is left under solder resist.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR印刷前の板面に、欠陥識別テープやその屑、セロテープ等が取り残され出来たもの（SR印刷前工程）

【原因、判断要点、发生工序】在SR印刷前的板面残留标识胶带及其屑、透明胶带等而引起的（SR印刷前工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by defect-identification tape, its broken debris, cellulose tape or the like left unremoved on the board surface. (Before solder resist application)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】左の拡大顕微鏡倍率×

【注釋】左的放大显微镜倍率×

【Comments】Enlargement of left photo
Magnification: ×

2-1-2-30 SR 下地×印残り／SR 基底有 X 标记／“X” mark on the base material under solder resist

【特徴】SR 下地にカタやマジックで付けた×印などが残っている状態の欠陥

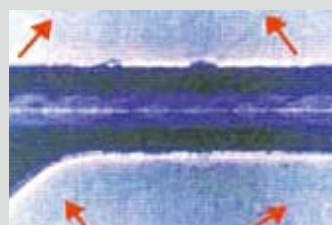
【特征】在SR 基底残留切割或者墨水的X标记等的缺陷。

【Characteristics】“X” mark formed by a utility knife or a marker is left on base material under solder resist.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR印刷前の板面に、不合格品識別用×印があるものが見逃されて良品とされたもの（SR印刷前工程、出荷検査）

【原因、判断要点、发生工序】SR印刷前板面有不良的识别X标记，没有检查出来而当成合格品所造成的（SR印刷前工序、出厂检查）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】A product carrying a “X” mark to identify a rejecting product on the board surface before solder resist application is overlooked and processed as an acceptable one. (Before solder resist application and delivery inspection).



【コメント】顕微鏡倍率×25

【注釋】显微镜倍率×25

【Comments】Magnification: ×25



【コメント】左の拡大顕微鏡倍率×25

【注釋】左的放大显微镜倍率×25

【Comments】Enlargement of left photo
Magnification: ×25